



招聘简章

中国赛宝实验室（CEPREI，工业和信息化部电子第五研究所）创建于1955年，工信部直属事业单位，国家级科研院所，是中国最早从事可靠性研究的权威机构。获得国内外授权和认可超八十项，所出具的检测分析证书或认证认可报告具有广泛的权威性，获得包括欧美日在内的四十多个国家和地区的认可。

可靠性分析中心是中国赛宝实验室的核心技术部门之一，致力于成长为中国产品失效分析、工艺可靠性以及可靠性整体解决方案的领先者。我们具有先进完善的设备资源和国内顶尖的技术专家队伍，以“使产品更可靠”为己任，开展元器件可靠性、材料可靠性、工艺可靠性以及产品可靠性整体解决技术的研究与工程服务。

序号	岗位名称	岗位代码	岗位职责	学历	专业要求	任职要求和说明	拟招人数
1	技术服务支持工程师	FX-ZC	1. 负责市场开拓，推广技术服务产品； 2. 负责售后跟踪、维护； 3. 负责调研相关市场情况等	本科及以上	材料科学与工程/电气工程/信息与通信工程/航空宇航科学与技术/市场营销等相关专业	具有良好的职业形象，思维清晰敏捷，逻辑分析能力强；能承受较大的工作压力，有较强的进取心	3
2	研发工程师（A）	FX-YF（A）	负责中心材料可靠性方向的技术研发与开拓、课题申报、科研课题研究以及科研渠道开拓等工作。	博士	复合材料、高分子材料、电子封装材料、材料模拟仿真	具备以下项目/科研经验者优先：复合材料物理工程实践，高分子材料寿命与老化理论与实践基础，电子材料测试评价基础，材料数据库设计与建设，材料高通量测试设计基础，工程化材料模拟仿真技术基础等。	2
3	研发工程师（B）	FX-YF（B）	1、电子产品板级以上产品可靠性技术研发，硬件测试及测试设备研发。 2、科研项目申报、实施、结题。 3、能力建设规划、设计、申报、实施。 4、对政府和机关支撑工作。	博士	电子科学与技术/电路与系统/电子信息工程/仪器仪表工程	熟练使用电路分析和仿真软件，具备硬件调测经验，能熟悉使用示波器、电子负载等测试仪器完成电子产品硬件测试及分析。	2
	研发工程师（C）	FX-YF（C）	1、主持先进封装领域测试分析与可靠性工作，开展技术需求分析、关键技术开发，提供封装技术综合工程解决方案，对技术竞争力研究； 2、主导小型化封装技术研究：SIP封装、3D IC集成等； 3、根据公司总体发展战略，制定本领域技术发展战略。	博士	电子封装、封装可靠性、材料连接、机械设计及相关专业	具备以下项目/科研经验者优先：电子封装工艺、封装测试及可靠性评价，微波工艺可靠性，电子产品热设计、信号完整性相关的数值模拟等。	2
3	项目工程师（A）	FX-XM（A）	1. 集成电路、分立器件芯片及封装的可靠性分析与评价； 2. 器件封测的可靠性咨询服务； 3. 集成电路、分立器件的应用可靠性分析和研究	硕士	电子科学与技术/微电子学与固体电子学/电路与系统(集成电路或功率器件相关)	集成电路相关专业优先	2

4	项目工程师 (B)	FX-XM (B)	1. 电路级失效分析与评价; 2. 硬件电路测试; 3. 电路级分析与测试技术研究	硕士	电子科学与技术/电路与系统/机械电子工程/仪器仪表工程	具有良好的数字电路和模拟电路等专业理论知识; 或具有硬件调测经验, 熟悉使用示波器、电子负载等测试仪器完成电子产品硬件测试及分析; 或具有自动化测试设备开发经验	2
5	项目工程师 (C)	FX-XM (C)	1. 企业可靠性工程体系建设咨询; 2. 产品可靠性设计、FMEA/FMECA等可靠性设计分析相关工作; 3. 可靠性试验等数据处理与分析等相关工作	硕士	安全科学与工程/控制科学与工程/工业工程	熟悉电子产品研发管理流程, 对各阶段的可靠性工作内容有一定的了解; 熟悉产品电子可靠性、维修性、安全性相关内容和标准, 如GJB、IEC 标准等优先	2
6	项目工程师 (D)	FX-XM (D)	1. 电子产品设计可靠性提升咨询与服务; 2. 电子产品环境与可靠性试验方案设计、实施及过程管理; 3. 产品故障分析; 4. 企业可靠性咨询与评价服务	硕士	控制科学与工程/电子科学与技术/电气工程/仪器科学与技术	具有电子产品设计/试验/测试经验, 熟悉电子产品环境与可靠性试验相关标准者或熟悉热学参数测试与热仿真技术者优先	2
7	元器件失效 分析工程师	FX-SX	负责元器件及电路模块的测试与可靠性分析、失效分析	硕士	电子科学与技术/微电子学与固体电子学/电磁场与微波技术/电路与系统/材料科学与工程/物理学/电力电子与电力传动	具备较强的逻辑推理能力; 有电路设计开发、芯片设计与工艺制造等经验者优先	7
8	工艺技术开发 工程师	FX-GY (A)	1. 网络分析仪、探针台等高速高频设备的应用开发; 2. 高速高频板材及射频连接器信号测试分析技术开发、夹具开发及行业标准研究; 3. 电学不良类模块或连接器的失效分析; 4. 常用 PCB 测试图形的制图	硕士	通信工程/电磁场与微波技术/电路与系统/材料科学与工程	具有良好的模拟电路、数字电路、电磁场与微波、信号处理的基础, 熟悉 PCB 和 PCBA 制造加工流程或连接器的生产过程, 熟练运用网络分析仪、示波器、阻抗分析仪等设备, 具有高速高频 PCB 开发经验或射频连接器开发经验者优先	2
9	材料可靠性 工程师(A)	FX-CL (A)	高分子材料失效分析评价、可靠性评估、新技术/新项目的开发及实施等	硕士	材料科学与工程	具有高分子材料相关知识, 具有胶类材料的科研、项目及相关课题经验者优先	2
10	材料可靠性 工程师(B)	FX-CL (B)	1、负责电子工艺材料项目开发与实施; 2、负责电子工艺材料失效分析及可靠性相关工作; 3、负责电子工艺材料科研与新技术开发。	硕士	材料类/化学类	有高分子材料学科背景, 具有胶类材料的科研、项目及相关课题经验者优先。	2
11	材料可靠性 工程师(C)	FX-CL (C)	1. TEM、双束 FIB、XRD 等仪器的使用和开发; 2. 研究仪器在失效分析方面的应用	硕士	材料科学与工程/物理学	具有块体晶体材料研究背景, 熟悉晶体学知识, 具有 TEM 操作经验者优先	2
12	检测工程师	FX-JC	1.完成检测评价试验和报告编制; 2.跟进技术发展, 形成技术沉淀	本科及以上	电子科学与技术/微电子学与固体电子学/通信工程/材料科学与工程/物理学/化学等相关专业	专业基础扎实, 具有实验室相关实习经验者优先	3

注：

以上岗位都需要具备良好的沟通协调能力、善于学习和钻研、有团队协作精神及客户服务意识；

联系我们：

有意者请将简历发送至 hr-fx@ceprei.com，邮件主题注明“岗位名称-姓名-院校-专业”。

单位地址：广州市天河区东莞庄路 110 号

官网：<http://www.ceprei.com>

想要了解更多信息，请关注微信公众号：赛宝可靠性

